

可接受质量水平AQL:0.065%

取样方式(Sampling Plan):任意选取

作业人员 (Operator):

注意事项Note:

1. 资料核对:

核对流程卡，实物和MES系统三者的数量，品名，规格，批次，出货型号等信息是否一致。

2. 数量清点

□Tray盘来料, 请统计每盘Tray IC数量, 并相加填写下表。

序号(盒):	1	2	3	4	5	6	7	合计(PCS)
数量(PCS):								

3. 外观检验

- A、IC外观、边缘完整无缺、没有裂纹、刮等明显痕迹
B、Mark内容正确、印制清晰、完整、Mark位置无偏移
C、BGA球体大小均匀、无缺球、偏移不良
D、基板有无刮伤、裂痕

FT 生产测试站别: FT

如果发生良率异常请填写“FT品质异常通知单”(Low Yield Report#):

Load board: SPR-001~003

作业人员:

机台类型 Tester Type	正测程式(Normal Test Program.)	版次 Program Version
Tester:J750HD+P&P OS: Win7-64bits IG-XL Vrsion: 3.60.10		

Tester 设定:

1. 确认当前为WIN7操作系统，IG-XL版本
2. 双击桌面：OI
3. 选择test session: First Test，如需GU选择“GU Test”
4. 根据提示刷入customer LOT ID 等相应信息
5. 点击“ok”
6. 待程式TDR run 结束后点击“start test”

Handler 設定:

1. 检查Recipe: BGA11*10
2. 确认连接Tester: online, GPIB
3. Site mapping 确认: 1 2 3 4
4. 确认FT开启Alarm (continue fail), RT时关闭
5. Test bin 设定: **13045**. Test bin 设定: **1304**

Bin Assign		
AUTO1	1	Pass
AUTO2	6	Fun Fail
AUTO3	4, 11	Fun Fail
FIX1	3	O/S Fail
FIX2	5	Fun Fail
FIX3	2, E, 15	Fun Fail

注意事项: 1. 技术员setup结束后, 测试首盘通知QC检验无问题后方可继续测试, 后续每隔3小时QC巡检一次

2. RT1良率小于10%则无需RT2
3. 如果Bin2 Yield> 0.35% 或最后一次retest bin2的数量大于前一次retest bin2的数量时, 请再针对bin2做一次retest.
4. 测试PASS品不满盘需单独放置, 结批时进行补料动作。

5. EQC Fail复测2次后若仍有Fail, 需立即联系PE处理。(PE处理时如手动测试Pass, 请PE在Summary EQC数据记录栏签字)

6. 针对EQC fail 客户未release的情况, 产线先包PASS品, 最后留2擦PASS品不包装, fail 品不包装, 包装后hold。
7. 针对FT yield 未达标或单个BIN fail 超标客户未release情况, 产线PASS 品全部包装, fail 品不包装, 包装后hold。

Hold 机制:

- 客批良率卡关: bin1 \geq 95%, Bin2 <0.35%, Bin3<1.61%, Bin4<2.59%, Bin5 <2.24%, Bin6<1.67%

2. Summary 数量和实物数量不匹配, Summary数量比实物少或Summary数量比实物数量多于20ea.

FT 生产测试站别：EQC		
机台类型 Tester Type	正测程式(Normal Test Program.)	版次 Program Version
Tester:J750HD+P&P OS: Win7-64bits IG-XL Vrsion: 3.60.10		
如果发生品质异常请填写“FT品质异常通知单”（Reject Report #）：		
抽检频率：AQL0.065		作业人员 (Operator)：
注意事项(Notes)：		
1. EQC抽测数量：批次总数< 35K ，EQC 抽样量为：672颗（4整盘tray）；批次总数>=35K ，EQC 抽样量为：1512（9整盘tray）； 2. EQC必须用FT1测试PASS后的产品测试，不可用RT后的PASS品 3. EQC复测不能超过3次，测试结束后若有1pcs fail需hold当批，通知工程师处理 4. EQC结束后结批，需清点所有BIN别数量，与runcard核对OK后流入下制程。		
FT 生产测试站别：FQC		
如果发生品质异常请填写“FT品质异常通知单”（Reject Report #）：		
作业人员 (Operator)：		
注意事项(Notes)：		
1. 核对runcard数量与实物数量是否一致。 2. 核对Tray盘型号、Bin 卡内容、Bin标签与Bin的一致性 3. 产品Pin1点是否对应Tray盘缺角方向		

FT 生产测试站别：PACKING	
如果发生品质异常请填写“FT品质异常通知单”（Reject Report #）：	
作业人员 (Operator)：	
注意事项(Notes)：	
1. 打带要求：3短一长，接头处偏移量不可超过1/3 2. Fail 品包装标签上加贴红点	

FT 生产测试站别：OQC1	
如果发生异常请填写“FT品质异常通知单”（Reject Report #）：	
取样方式 Sampling Plan:全检	作业人员 (Operator)：
注意事项(Notes)：	
1. 内标签（铝箔袋、pizza box）所贴位置、内容 2. 抽检部分ICL标签条形码，扫描检验信息，并做好记录 3. 整批抽完真空后开始检验，真空失效不大于20%即可通过	

FT 生产测试站别：OQC 2	
如果发生异常请填写“FT品质异常通知单”（Reject Report #）：	
取样方式(Sampling Plan):全检	
作业人员 (Operator)：	
1. Label检查（内容、破损、打印质量、合批数量） 2. 铝箔袋真空封装、外箱包装质量检查.	

Summary

FT1

工号:

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fail											

RT1

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fail											

RT2

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fail											

RT3

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fail											

RT4

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fail											

EQC

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良	工程 签字 (日期)
Pass			Fail												
工程验证															
Pass			Fail												

Final Yield

Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Yield														
Pass			Fail											

Bin1:PASS Bin2:O/S Bin3/4/5: Function fail Bin6: RFfail Bin11: -- Bin15:--

Loss:实际测试数量与来料数量的差异

注意: G/S/F开头客批良率卡关: bin1≥95%,Bin2 <0.35%, Bin3<1.61%, Bin4<2.59%, Bin5 <2.24%, Bin6<1.67%

□是 : 整批次结束测试数据比实物多出20ea以上 (若达到请勾选"√").



FT 机台落料记录表

机台 (Tester):						产品型号:				生产批号:			
序号 序号	日期 时间	拾料				处理				备注			
		制程	Mark	(ea)数量	(姓名)拾料人员	落料处理方式	(ea)颗数	(姓名)处理人员					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

落料范围：机台上及周边区域

落料处理流程： 1、检查Mark, 确认是否为本批次；
2、若是当前本批产品，确认产品外观有无异常：无异常，放入未测品中进行测试；外观异常，计入Other外观次品中；
3、若不是本批产品，放入BGA落料盒。

落料处理目的： 防止混料

落料处理方式： ① 放入未测品中测试 ② 放入BGA落料盒 ③ 放入Other外次